证券代码：300223　　证券简称：君正股份

北京君正集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20261127

投资者关系活动类别	■特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　□路演活动 □现场参观 □其他　（_____）
参与单位名称及人员姓名	西部证券：齐天翔；华福电子：刘贤沽；财通证券：蒋鹏坤；华夏未来资本：丁鑫等
时间	2026 年 11 月 27 日
方式	现场交流会
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张敏
投资者关系活动主要内容介绍	**1、公司预计四季度存储的毛利率是否还会上涨？明年如何看？** 四季度部分存储产品价格仍有可能有一定上涨，预计四季度存储产品毛利率会继续增长。明年的价格目前无法给出明确预测，目前看一季度有可能会有一定涨价。预计明年 DRAM 供应仍会比较紧张，Flash 供应也在趋紧。 目前来看，存储产品市场需求仍然比较大，尤其在汽车、工业等利基市场，随着国际大厂逐步退出 DDR4、LPDDR4 等细分领域，我们有大量新增的需求；Flash 领域，汽车、工业市场需求很好，同时 AI 服务器领域需求强劲，从客户给我们明年订单的预测成长性来看还是非常好的。 **2、目前看到汽车的需求并没有那么旺盛，那我们的汽车客户需求是否稳定？**

	确实，今年从整体汽车市场来看需求增长是有一定压力的，但对我们来说，由于大厂将更多的资源放在更高收益的 HBM，逐渐退出 DDR4、LPDDR4 市场，我们面对的需求增长了很多，去年底以来，有不少友商的客户想找我们采购，实际情况是我们并没有办法满足所有的客户的采购需求。 **3、目前 DRAM 存货情况如何？** 从已披露的数据可以看到，我们的存货水平还是比较高的，其中大部分是存储。除了现有的存货，我们 DRAM 也仍在持续生产。由于 DRAM 产能非常紧张，目前公司还是采用分货的方式，存货和持续生产的产品供应到 27 年底是没有问题的。 **4、目前 AI 放缓对公司是否有影响？公司如何看？** 目前我们看到 27 年的产能仍然偏紧，无法满足我们客户的实际需求，我们也没有看到大厂转回利基 DDR4、LPDDR4 这类市场的迹象，所以目前对我们来说，没有看到对需求有影响。 **5、目前公司在 AI 服务器里的销售情况如何？** 今年公司在 AI 服务器领域取得显著进展，与 AI 服务器领域的主要厂商保持密切合作，目前已成为头部厂商的主要供应商之一；随着 AI 市场爆发，公司持续获得订单更新，预计在该领域明年会有更多增长。 **6、公司在 NAND Flash 上有哪些布局和规划？** 目前 NAND Flash 的产能仍然比较紧张，从车规市场来看，NAND Flash 的价格还是比较坚挺的，基本没有出现价格下调。 公司已在 SLC、MLC 等 NAND Flash 领域做了大量工作以进行产能储备，相关产能预计将于明年下半年或 28 年陆续释放并投入市场。 **7、计算芯片毛利率情况？** 计算芯片主要是消费市场，由于存储原材料缺货涨价，公司计算芯片也相应涨价，前三季度毛利率持续提高，目前看三季度可能是毛利率的高点，后续有可能会开始回落，具体需视市场情况而定。目前公司已开发不带 KGD 的产品，客户可以灵活地安排自己的产

	品规划。此外，明年 AI-MCU 将开始量产销售，对计算芯片的收入会是一个增量。 **8、存储芯片上游供应商涨价对后续毛利率的影响大吗？** 今年公司存储产品调价可以覆盖成本上涨，因此毛利率一直在增长，预计全年存储芯片的毛利率有可能都是持续提升的。目前来看，明年一季度部分物料可能还会有一定的涨价。客观上说，产品不可能一直涨价，因此，预计未来会存在一定阶段，产品售价不再上调，毛利率到顶，但目前看就 DRAM 来说，需求还是比较多，供应还是很紧张，因此还无法准确判断会是什么时候。同时，从产业长期发展来看，无论周期如何波动，随着 AI 在端侧、在更多领域的渗透，存储的需求规模会持续增长，整个产业的发展是很确定的，我们还是面临着很好的时代机遇。 **9、AI MCU 面向哪些市场应用？** 传统的 MCU 用在非常多的领域，像办公设备、家电、工业，还有很多的消费电子领域。随着 AI 不断地向终端渗透，现在很多原来并不需要算力的设备，开始需要有更精准的识别、更精细的控制，相应地就需要跑一定的算法，从而就需要有一定的 AI 算力，有 NPU。具体来说，比如 AI 图像识别类：门禁、门锁等，AI 屏显类：家居家电屏显、医美屏显、工业 HMI、中控屏等、AI 音频类：如 VOIP 话机、以及其他 AIoT，如烤箱、喂食器等，还有工业控制等领域，这个应用领域是非常广的。 **10、3D DRAM 和 Wide I/O 的进度情况？** 从进度上看，预计 Wide I/O DRAM 有望较 3D 堆叠 DRAM 更早实现量产，由于 3D DRAM 需要代工厂的资源较多，目前产能紧张，进度相对较慢。Wide I/O DRAM 主要面向端侧应用，目前已与客户配合开发，容量覆盖 1Gb 到 16Gb，带宽更宽，在手机、穿戴等端侧 AI 领域均可应用。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 11 月 27 日